

**2024-09-18 Qualcomm Daily Media Scan**

[**Qualcomm相關新聞**](#Qualcomm相關新聞)

[**MediaTek相關新聞**](#聯發科相關新聞)

AI PC 亂鬥！引爆產業爭霸戰 雙A、聯發科等台廠不缺席

[**無線通訊市場**](#無線通訊市場相關新聞)

[**智慧型手機/消費性電子產品**](#智慧型手機)

AI PC 混戰中 電腦品牌廠...力拚差異化

台積電通吃安謀架構處理器訂單 AI PC 熱潮最大贏家

[**其他業界重要訊息**](#其他業界重要訊息)

新一代華碩電競手機提早推出？ROG Phone 9傳過中國3C認證

三星獲得美國Ambarella人工智慧晶片公司2nm製程訂單，標誌著三星取得突破

vivo X200系列可能降為90W快充 X200 Pro效能跑分傳曝光

LTN經濟通》台積電的蜜糖 卻是它的毒藥？

華碩電競機強化 AI 功能 ROG Phone 9明年首季亮相

路透社指稱Intel在2022年爭奪Sony PlayStation 6處理器失利，AMD將再次拿下下一代PS主機晶片訂單

|  |
| --- |
| **Qualcomm相關新聞** |

|  |
| --- |
| **MediaTek相關新聞** |

AI PC 亂鬥！引爆產業爭霸戰 雙A、聯發科等台廠不缺席

2024-09-18 / 經濟日報 / 吳凱中

https://money.udn.com/money/story/11162/8233921

AI PC不僅代表個人電腦邁向AI時代，也掀起產業的另一波霸主地位爭奪戰。過去個人電腦作業系統霸主微軟這次挺安謀（Arm）架構，扶持高通，微軟+高通領軍新世代AI PC「Copilot+PC」，以WoA （Windows on Arm）概念，挑戰英特爾（intel）領軍、將近半世紀的x86陣營處理器霸主地位。

英特爾2023年率先喊出AI PC，2023年底推出Core Ultra系列處理器，搭配宏碁首發搭載新處理器的產品，意圖取得AI PC話語權。但短短半年內，市場群雄並起，作業系統霸主微軟握有生成式AI技術，以軟體角度定義AI PC需要具備「算力」，硬體業者包括高通（Qualcomm）、超微（AMD）紛紛推出滿足微軟Copilot+PC架構的NPU。

目前，品牌電腦業者幾乎全面推出AI PC，業界關注兩大重點，首先，新的Arm架構能否撼動x86在PC市場的地位？其次，AI PC到底是不是提振PC需求的殺手級應用？

以過去的平台架構來看，擺脫英特爾且成功的唯一案例只有蘋果的Mac系列，蘋果過去也是英特爾客戶，但蘋果從未放棄自研晶片，2020年「Apple Silicon」轉型完成推出第一款採用Arm架構M1晶片，證明Arm架構處理器效能不輸x86，在續航力上更勝一籌。

蘋果動搖了x86地位。微軟轉向扶持高通，採用Arm架構的Snadragon X系列行動平台支援微軟最新Copilot+PC，更在6月18日率先上市，搭載x86架構的英特爾、超微晶片的產品，要晚一至兩個月才開賣。

Arm架構的成功讓其他領域的晶片業者也想來搶占PC市場。高通之外，攻擊x86陣營的還有聯發科，市場盛傳，聯發科鎖定WoA生態系的Arm架構PC處理器將在2025年亮相。

外資大摩認為，WoA是推動明年AI筆電普及率迅速增長的驅動力，估計市占率將由今年的8%跳升至2025年的30%、2026年再升至50%。

幾乎可預見，在兩年內就會出現WoA和x86的分庭抗禮，可能會讓英特爾的霸主地位更失色幾分。

不管廠商推多少產品，要有人買才算數。今年AI PC熱烈上市，PC品牌業者無一不說看好，但能帶來多少幫助？答案恐怕是「雷聲大、雨點小」。

研調機構預估，以高通平台為主的Copilot+ PC，全年出貨量預計將達900萬台以上；市調機構Canalys則預測，今年全球AI PC出貨量上看4,800萬台。微軟估計，雙平台加起來，2025年底前會賣出5,000萬台AI PC。

AI PC看起來是搶救低迷需求強心針，但通路商看法與品牌業者不一。

以3C為主力的PChome網路家庭集團董事長詹宏志今年在股東會後就明確表示「AI PC目前話題多於實質」，可能要等8月後更多新品問市，再看看對業績的效應。

而實體通路商和品牌電腦業者則認為，今年的AI PC出貨，很大貢獻是來自PC傳統換機潮。換言之，AI PC硬體雖大致到位，但軟體層面的AI殺手級應用仍尚未出現，不足以刺激更多消費者掏錢購機。

儘管品牌廠心知肚明，今年可能只是AI PC「前一年」，但包括宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾、惠普、聯想等主流PC廠仍持續推出全新AI PC，誰都不能在這場新世代電腦大戰中掉隊。

延伸閱讀

AI PC 混戰中 電腦品牌廠...力拚差異化

台積電通吃安謀架構處理器訂單 AI PC 熱潮最大贏家 $(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

|  |
| --- |
| **無線通訊市場相關新聞** |

|  |
| --- |
| **智慧型手機/消費性電子產品** |

AI PC 混戰中 電腦品牌廠...力拚差異化

2024-09-18 / 經濟日報 / 吳凱中、蕭君暉

https://money.udn.com/money/story/11162/8233923

AI PC出現以英特爾（intel）、超微（AMD）的x86架構，以及搭載高通（Qualcomm）採用Arm架構設計的Snapdragon X處理器新筆電。各家PC品牌廠共同特點是強大效能與電池續航力，但在AI PC混戰中，不少廠商力求差異化。

戴爾（DELL）大量推出搭載高通CPU的機種，聯想在自家AI PC產品配備個人化的AI agent智能體「聯想小天」，惠普（HP）從資安下手，利用機器學習技術，在商用PC市場突圍。

戴爾是WoA（Windows on Arm）架構「Copilot+PC」最強支持者，當同業還在觀望高通新款PC處理器時，戴爾一次推出五台搭載Snapdragon X Elite與X Plus處理器的AI PC，涵蓋商務、消費主力系列。

全球PC霸主聯想推出號稱「地表最強」AI PC系列產品。聯想集團董事長兼CEO楊元慶指出，聯想的AI新產品具備五大特性：配備個人化的AI agent智能體「聯想小天」，具備為每個擁有者建立個人知識庫的能力，以及開放性的AI應用生態等。

聯想也宣示強化AI生態系與應用，喊出年底前AI應用大增逾20倍、達上千款，以多元軟體應用刺激硬體銷售。

惠普因應高通新處理器，推出Omnibook X及Elitebook Ultra新機，搭載自家的AI軟體「HP AI Companion」提升效能外，在部分機種搭載Wolf Pro Security NGAV新一代防毒軟體，導入機器學習技術提升AI PC的資安。

台灣品牌雙A推出的AI PC涵蓋高通、英特爾及超微CPU機種。宏碁（2353）與華碩（2357）不約而同選擇旗下主流產品線Acer Swift、ASUS Vivobook列為首款支援Copilot+PC產品，搭載Snapdragon X Elite或Snapdragon X Plus平台。

微星（2377）與技嘉（2376）也都推出涵蓋各平台的AI PC產品，認為AI PC今年開始起步，預估2025年出貨量較大，主要是各種軟體陸續上路帶動需求，微軟新作業系統的AI功能，也可望刺激買氣。

電競大廠微星董事長徐祥表示，AI PC的市場會慢慢發酵，隨著愈來愈多應用，AI PC的商機會逐步成長。但AI PC曲線何時起飛，技嘉董事長葉培城說，從現在開始，所有東西都圍繞AI，第一步是AI伺服器，AI PC剛要開始，要說多快，其實還要學習，但是明後年的趨勢將更明顯，因為大家都往應用端發展。 $(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

台積電通吃安謀架構處理器訂單 AI PC 熱潮最大贏家

2024-09-18 / 經濟日報 / 尹慧中

https://money.udn.com/money/story/11162/8233924

台積電（2330）通吃安謀（Arm）架構AI PC處理器代工訂單，伴隨英特爾處理器委外釋單量擴大，台積電無疑是這波AI PC熱潮大贏家。

研調機構COUNTERPOINT發布報告指出，AI PC市場規模將持續成長，預計到2027年，市面上75%的筆電將配備先進的生成式AI功能，將顯著提升半導體的價值。

在這當中，AI PC處理器呈現百花齊放態勢，包括蘋果、高通等大廠，都以安謀架構設計AI PC處理器，並都找台積電操刀，讓台積電先進製程訂單持續熱轉。

蘋果搶搭AI商機，推出「Apple Intelligence」，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私，並宣布與OpenAI結盟，透過ChatGPT提供多元AI服務，在搭載A17 Pro或M系列晶片的iPhone與Mac系列產品更新至最新iOS系統後，即能使用AI服務，市場看好將掀起果粉新一波換機潮，台積電為蘋果處理器獨家代工廠，同步沾光。

高通也端出整合微軟CoPilot+功能的AI PC處理器，搭載高通全新驍龍X平台的AI PC已陸續問世，掀起市場話題，預料也將有不錯的成績，台積電為高通操刀生產相關晶片，業績進補。

傳統x86架構處理器廠商也沒放過AI PC商機。英特爾方面，依據該公司先前最新Lunar Lake平台相關內部設計資料流出資料，已將中央處理器（CPU）委由台積電以3奈米製程代工，讓台積電首度迎來業界期盼多年的英特爾主流筆電平台CPU大單。

加計原本已談妥的Lunar Lake的繪圖處理器（GPU）、高速IO（PCH）晶片等合作，台積電操刀有望擴及英特爾關鍵平台全數主要晶片 。

英特爾執行長基辛格先前已透露，今年Arrow lake及Lunar lake系列CPU晶片塊（tile）運算核心委由台積電以N3製程生產。外界看好，英特爾相關委外代工策略也將挹注台積電營收。

超微也正強化資料中心和AI加速器領域布局，目標2024年大幅提升市占，外界推估，超微去年為台積電第二大客戶，隨超微新平台推出，將成台積先進製程出海口。

延伸閱讀

AI PC 新品陸續問世 代工廠出貨量看增

AI PC 浪潮來臨 零組件營運添動能

$(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

|  |
| --- |
| **其他業界重要訊息** |

新一代華碩電競手機提早推出？ROG Phone 9傳過中國3C認證

2024-09-16 / 手機王 / 布小白

https://www.sogi.com.tw/articles/asus\_rog\_phone\_9/6262922

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

三星獲得美國Ambarella人工智慧晶片公司2nm製程訂單，標誌著三星取得突破

2024-09-16 / XFastest / sxs112.tw

https://www.xfastest.com/thread-292284-1-1.html

據報導三星代工廠已經獲得了2nm的主要客戶，即美國Ambarella人工智慧晶片公司，這家韓國龍頭尋求獲得市場主導地位。

三星目前正在半導體產業中摸索前進，因為該公司的代工部門尚未取得決定性突破，特別是在高階製程方面。更令人困惑的是有報道稱三星的製程（尤其是3nm GAA）未能達到行業標準的良率，這表明這家韓國龍頭在市場上正經歷著一段艱難時期。不過The Elec現在報導稱三星代工已經獲得了2nm客戶，即美國著名半導體設計公司Ambarella。

經過一番研究，我們了解到Ambarella設計和開發影/片壓縮和影像處理解決方案，而解決方案是指專用SoC。這些晶片專門用於分析來自攝影機的視覺數據，透過使用人工智慧，Ambarella的晶片特別用於汽車應用以及監控系統。雖然這家美國公司的規模不如一些人工智慧參與者，但這對三星來說絕對是一場勝利，因為 Ambarella是首批獲得2nm訂單的客戶之一。

就三星的2nm製程而言，該公司預計將在2026年或2027年進行晶片Tape-Out，商業化生產也將在同一時間內進行。就製程本身而言，除了這家韓國龍頭仍然面臨良率問題之外，我們還沒有真正看到太多相關報導，但考慮到三星正在通過改善現有設施並與客戶合作，致力於提高產量。

這家韓國巨頭的製程擁有主流客戶，例如高通的Snapdragon 8 Gen 5 SoC，還有NVIDIA，但鑑於目前高階製程的狀況，三星還有很多工作要做。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

vivo X200系列可能降為90W快充 X200 Pro效能跑分傳曝光

2024-09-17 / 手機王 / 布小白

https://www.sogi.com.tw/articles/vivo\_x200\_pro/6262932

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

LTN經濟通》台積電的蜜糖 卻是它的毒藥？

2024-09-18 / 自由時報 / 季辛格的復興計畫 全破滅

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4800125

歐祥義／核稿編輯

美國科技大廠英特爾（Intel）近期利空消息頻傳，執行長季辛格（Pat Gelsinger）力推的晶圓代工業務，遲遲沒有回報。8月初公布令人失望的財報後，還宣布裁員上萬人，導致股價狂瀉、股東的不滿提告，英特爾更宣佈將削減營運成本，且近幾日還傳出美國將延後發放《晶片法案》補助資金消息，引發市場猜測英特爾下一步該何去何從。

英特爾（Intel）日前公布2024年第2季財報，營收持平，是以合併報表來看，英特爾本季虧損16億美元（約新台幣512億元）。《彭博》報導，英特爾的慘況粉碎了季辛格 （Pat Gelsinger） 於2021年接任執行長時所提出的復興計畫，打擊啓動轉虧爲盈計劃的最後一絲信心。

自8月初英特爾公布災難性的第2季財報後，英特爾除了宣布裁員1.5萬人外，還包括縮減數十億美元設廠計畫、出售子公司、甚至將該公司的核心業務分拆爲獨立公司，並暫停配息，希望藉此推進營運模式轉型，扭轉晶片製造業務長期虧損的局面。

在英特爾深陷財務困境後，市場猜測英特爾的下一步可能會拆分業務。自此，陸續有爆料傳出，英特爾已出售其在英國晶片設計公司安謀（Arm）的持股，甚至還考慮出售自駕軟體供應商Mobileye的部分股權、部分設計業務、晶圓代工事業、出售Altera，以及放棄德國廠。

要知道，去年英特爾就出售了部分Mobileye持股，當時募資約15億美元，就是為了晶圓代工業務，但現在又傳出它要再賣持股。Mobileye股價８月１3日下跌 8.5%，跌至 11.55 美元，創新低，市值為 94 億美元，遠低於 2022 年 12 月 IPO 時的市值 170 億美元（每股 21 美元），2024年迄今，股價跌幅超過7成。

目前，英特爾正遭遇史上最糟時期，處理器缺貨與遞延、晶圓代工業務虧損持續擴大，股價跌到10年來低點、現金流難以支撐其資本開支，試圖力挽狂瀾的季辛格，似乎離當初設定的遠大目標，越來越遠。

英特爾股價在8月13日收盤每股19.66美元，接近史上最低點。

《彭博》直言，一個習慣於定義客戶產品、收取高價和大肆支出，以壓倒競爭對手的公司，現在要學會將自己作為合作夥伴進行推銷，英特爾必須說服一群持懷疑態度的公司，並擺脫被英特爾支配的陰影並信任，這對英特爾來說是非常艱難的任務。

外媒分析，英特爾若想擺脫下滑境勢，最迫切的問題，是應盡快解決晶圓製造的這個燙手山芋，而不是脫手其他事業。

照理來說，以英特爾在PC、一般伺服器處理器，都還佔有一席之地來說，產品設計有競爭，只要晶圓代工虧損止血，不是沒有救。但季辛格上任後，不斷透過蓋晶圓廠，試圖推動英特爾復興。

但在台積電、三星強大的競爭之下，並沒有顯著效果，反而加劇財務負擔，造成去年至今年以來連續虧損。

市場認為，不管季辛格的堅持是如何，越早擺脫代工業務，對英特爾越好。但要注意的是，即便英特爾決定出脫晶圓代工部門，能否找到潛在買家也存在疑問。

雖然台積電、三星都擁有足夠經驗與資金，但知名半導體分析師陸行之認為，儘管英特爾分拆符合預期，但以英特爾現在每處理1片1萬美元晶片，就要虧損6550美元、且成本約為台積電3倍的狀況，即使是免費奉送製造部門，也還是「誰接誰燙手」。

就如華爾街投資機構伯恩斯坦（Bernstein）在報告中表示：「英特爾現在只剩一系列，且一場接著一場的災難。」

另外前面提到，英特爾在PC、一般伺服器處理器，都仍有一席之地。英特爾預期，今、明兩年自家AI PC處理器出貨量合計將達1億顆，市調機構Canalys資料顯示，在桌機與筆電市場，英特爾仍占有絕對的領先優勢，至去年底為止，英特爾的市占率仍高達78％，這也顯示在PC市場上，英特爾即使勢頭不再，基本盤仍未潰散。

但在多方爆料英特爾各種賣身家求生存消息出來中，居然還出現英特爾考慮賣設計業務，外媒爆料，高通對英特爾的個人電腦業務有興趣，但對伺服器部門的收購興趣不大。

陸行之直言，原以為英特爾只要把晶圓製造部門這個毒瘤割掉就好，但英特爾若連75%至80%市佔的核心PC CPU設計部門都要賣，就跟「敗家子賣祖產」沒兩樣。

Synovus Trust資深投資組合經理摩根（Daniel Morgan）認為，英特爾應該減少其野心，專注於某一領域的成功，現在對英特爾來說，最好的道路是從製造領域撤退，專注於設計。他更說：「你不可能繼續做多件事，卻什麼都沒有做好。」

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

華碩電競機強化 AI 功能 ROG Phone 9明年首季亮相

2024-09-18 / 經濟日報 / 吳凱中

https://money.udn.com/money/story/5612/8233857

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺手機事業，近日傳出已在準備下一代ROG Phone 9電競手機，新機已取得中國大陸3C認證，同時曝光了充電規格。市場預計新款電競手機將於明年首季亮相，將配備高通最新處理器Snapdragon 8 Gen 4，並將新增更多人工智慧（AI）功能。

大陸認證網站訊息顯示，華碩一款新手機通過大陸3C認證，型號為ASUSAI2501A，維持65W的快充標準。業界認為，華碩通過認證的新機就是下一代的電競手機ROG Phone 9，高通今年10月將發布新一代Snapdragon 8 Gen 4旗艦處理器，市場預期華碩ROG Phone 9將導入高通最新款處理器。

在此之前，市場傳言華碩ROG Phone 9重點升級將放在散熱系統的提升，優化遊戲體驗，業界也預期華碩新一代電競手機將在明年1月發布，維持上一代機種發布時間節奏。

華碩目前手機產品主要分兩大產品線，包括針對電競市場的ROG Phone，以及鎖定主流市場的Zenfone系列，該策略短期內將不會有太大變動；隨著生成式AI技術在近年崛起，華碩兩大手機線也加大力度拓展AI功能。

華碩今年手機策略主打AI服務，Zenfone 11 Ultra具有AI即時通話口譯功能，在通話過程中雙向即時翻譯，跨語言通話無障礙。 還有AI搜尋助手、AI錄音筆記、AI語音降噪、AI智慧桌布等一系列功能。

外界預料，華碩下一代電競手機ROG Phone 9，將新增或優化更多人工智慧功能，今年的ROG Phone 8，華碩在AI相關技術上配備包括AI辨識快搜、相簿智慧搜圖、AI語音降噪等，讓手機與使用者互動更聰明。

華碩今年1月發布ROG Phone 8系列，包括ROG Phone 8、ROG Phone 8 Pro與ROG Phone 8 Pro Edition，相較過往強烈電競元素設計風格，ROG Phone 8設計往主流手機市場靠攏，以吸引更多一般用戶。

延伸閱讀

華碩智慧手機專利授權金 挹注事業群

$(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

http://www.investor.com.tw/Mobile/content.asp?articleNo=14202409160096

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

路透社指稱Intel在2022年爭奪Sony PlayStation 6處理器失利，AMD將再次拿下下一代PS主機晶片訂單

2024-09-17 / Cool3c / Chevelle.fu

https://www.cool3c.com/article/224710

AMD已經拿下Sony PlayStation主機兩個世代的晶片訂單，先前更傳出AMD主管指稱PS4的訂單挽救當時處於谷底的AMD，考慮到架構延續性，理論上Sony應該會繼續與AMD合作，不過路透社報導指稱Intel曾設法與AMD爭奪下一世代PlayStation主機(暫稱PlayStation 6)的晶片訂單，但最後Sony仍舊選擇與AMD繼續合作。

路透社引述3位知情人士的說法，指稱Intel在2022年與AMD競爭PS6晶片失敗，也同時對Intel當時剛準備起步的晶圓代工業務造成打擊，因為根據估計，若Intel取得晶片訂單，每個月將會供給數千片晶圓與創造數十億美金的營收，且至少將會維持5年以上，消息來源指稱Intel評估至少能創造300億美金的營收。Intel雖然從許多競爭者當中脫穎而出，並與AMD成為最後兩家競爭者，但Intel爭取訂單失敗的原因是與Sony在利潤上未能達成共識，最終Sony仍選擇繼續與AMD合作。

雖然看起來Sony在2022年就開始決定下一代主機的晶片似乎為之過早，不過以每一個世代的遊戲機黃金生命週期將近10年的情況下，及早規劃下一代遊戲機的架構並無不妥，不過無論是Intel、Sony、AMD或是博通都未證實此傳聞。

但若依照當前遊戲機的產業生態，此傳聞仍有許多值得商討之處，畢竟Sony從前幾代主機的向下相容性學到許多慘痛的教訓，顧及能夠減少與前一代主機的向下相容並便於開發者銜接，Sony(以及微軟)現在恐怕很難捨棄x86 CPU。AMD當前的優勢是由於可提供相對平衡的CPU、GPU與客製化能力，但Intel目前的GPU發展還沒有太顯著的成果，AMD雖然GPU仍落後NVIDIA，但單論GPU現況仍優於Intel；故假設此傳聞是真的，相信Intel未能拿到訂單並不僅只是利潤問題，也包括Intel是否具備提供類似AMD般的完整解決方案的能力。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

https://news.cnyes.com/news/id/5718659

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

https://www.cw.com.tw/article/5131958

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

https://finance.ettoday.net/news/2818270

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

https://m.cnyes.com/news/id/5718518

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

https://news.cnyes.com/news/id/5718608

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─